

ZettaCore (R) 發佈分子介面技術

納米處理技術可以低本地轉化為高性能的積體電路基板和印刷電路板

亞洲網美國丹佛和日本京都 4 月 16 日電。分子電子技術的開發商 ZettaCore 公司今天發佈了分子介面技術 (MI)。這種納米處理技術可以顯著增強密度互連，而無需採用昂貴且費時的新材料和工藝。

系統級互連是半導體元件和數位系統升級的一個瓶頸。ZettaCore 的 MI 技術使銅得以在光滑平整介電材料上沉積並使介電材料於光滑銅面壓合後有充分的接著力。由於省去了標面粗化，客戶即使將傳統材料用於高性能的積體電路基板、高密度板、高速板、柔性印刷電路板和晶圓級封裝，亦可以獲得更精密的線寬/線距的維度並改善信號的完整性。

日本 Ajinomoto 公司特種化學物質部門總經理 Takao Sakurai 說，“ZettaCore 的 MI 技術使積體電路基板客戶能夠充分利用其現有生產基礎設施，而獲得更精密的線寬/線距。例如，客戶可以藉由現有的 GX-13 材料改進線路尺寸，而這在傳統的粗化技術中是無法實現的。銅/介電材料光滑平整介面大幅降低了皮層效應導致的訊號損失，這將提高系統的性能。我們期待繼續與 ZettaCore 公司進行合作。”

ZettaCore 公司和 Ajinomoto 公司將在日本京都舉行的電子封裝技術國際會議上 (2009 年 4 月 14 日 -16 日) 提出一份關於 PCB 基板分子介面技術的報告。通過與 Ajinomoto 公司的合作，ZettaCore 公司將為基板製造商提供一個完整和無縫的解決方案。

ZettaCore 商業開發副總裁 Srinivas Nimmagadda 說，“Ajinomoto 公司的 GX-13 積層樹脂目前為覆晶積體電路基板材料的主流，藉由 ZettaCore MI 技術與 GX-13 材料的結合，客戶現在可以獲得 10 μ m 以下線寬/線距的設計。”

關於 ZettaCore (R)

ZettaCore 公司是一家分子電子技術的開發商。ZettaCore 的目標市場包括分子介面材料，能源儲存和半導體記憶體。藉由 ZettaCore 的化學技術，客戶可獲得精密的線寬/線距，以及減少積體電路基板和高速板中皮層效應的損失。欲知更多資訊請點擊 www.zettacore.com。